科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年5月24日現在

機関番号:3266	5		
研究種目:基盤研究(C)			
研究期間:2008~2010			
課題番号:20560308			
研究課題名(和文)	表面光電圧法によるフラットパネルディスプレイ用多結晶 S i 膜の結晶 性評価技術		
研究課題名(英文)	Development of crystallinity evaluation technique of poly-silicon film aiming at flat panel display on the basis of an alternating current surface photovoltage method		
研究代表者			
清水 博文(SHIMIZU HIROFUMI)			
日本大学・工学部・教授			
研究者番号:10318371			

研究成果の概要(和文):交流表面光電圧(Alternating current surface photovoltage: AC SPV) を用いて、多結晶シリコン(Si)薄膜の結晶性を非接触で評価できる装置を開発した。また、Si 単結晶表面を酸化した際の微量の金属不純物 [金(Au)、鉄(Fe)、クロム(Cr)]の挙動について AC SPV 法により明らかにした。更にこれらの金属不純物原子が Si 表面における酸化膜成長に 及ぼす影響を調べた。

研究成果の概要(英文): A novel instrument based on an alternating current surface photovoltage (AC SPV) was successfully developed to evaluate a crystallinity of Si poly-crystal thin film nondestructively. Simultaneously, irregular AC SPV characteristics were clarified for thermally oxidized Au-, Fe-, and Cr-contaminated n-type Si single crystal surfaces, respectively. The effects of these metal impurities on thermal oxide growth of Si surfaces were also investigated.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008年度	2, 300, 000	690, 000	2, 990, 000
2009年度	700, 000	210, 000	910, 000
2010年度	700, 000	210, 000	910, 000
総計	3, 700, 000	1, 110, 000	4, 810, 000

交付決定額

研究分野:工学 科研費の分科・細目:電気電子工学・電子・電気材料工学 キーワード:作成・評価技術

1. 研究開始当初の背景

AC SPV 法は,非接触・非破壊で半導体表 面のポテンシャルを計測可能な手法であり, 半導体表面の微量金属汚染計測や半導体表面 に形成される酸化膜中の電荷及び界面準位を 解析可能である。本手法により,微量の金属 [アルミニウム(Al), Fe, Cr, Au]の故意汚 染をした Si ウェーハについて, SPV 法を用 いて金属原子の挙動について調べ, Si 表面ポ テンシャル解析における SPV 法の有用性を 示してきた。また, Au 汚染した Si 表面を熱酸化したとき,酸化膜成長の増速が生じることが分かった。このような微量の金属不純物による極薄い酸化膜の成長への影響や金属原子の挙動を明らかにすることは、半導体集積回路製造にとって重要である。

一方,近年,フラットパネルディスプレイ (FPD)の普及とその大型化・高画質化が急速 に進んできた。FPDでは,発光素子を駆動す る薄膜トランジスタ(TFT)は,ガラス基板上に 形成した多結晶Si薄膜中に作り込まれるため, 多結晶Si薄膜の結晶性はTFTの特性を左右 する。また,FPDの大面積化により,多結晶 Si薄膜については,良好で,且つ面内で均一 な結晶性が求められており,これに対応でき る結晶性評価技術が必要である。現在,多結 晶Si薄膜の評価には,これまでSiウェーハ のキャリアライフタイム評価に用いられてき たマイクロ波光導電減衰法(µ-PCD)を用 いた装置が用いられているが,大型・高価で あり,ボトムゲート型構造のTFTでは評価が 出来ない。そこで,ACSPV法を用いた新し い多結晶Si薄膜の結晶性評価法を提案する。

2. 研究の目的

AC SPV 法を用いて,(1)新しい多結晶 Si 薄膜の結晶性評価技術を確立すること,(2) Si 表面,表面近傍(空乏層領域),バルクにおけ るキャリアの挙動を分別化して評価し,金属 汚染したSi表面における酸化膜成長と金属原 子の挙動との関係を明らかすることを目的と している。

3. 研究の方法

(1) SPV 法による多結晶 Si 薄膜の結晶性評価 新たに波長 365 nm の発光ダイオード を用いた励起光源と SPV 測定部を一体 化した小型 SPV プローブを作製し,これ を用いた非接触型の多結晶 Si 薄膜結晶 性評価装置を立ち上げた。また, SPV プ ローブ部の小型化と共に,平面分解能の向上 と高感度化を行った。本装置により,試料表 面と SPV 検出部のギャップ間隔と SPV の関係,ラインプロファイルの測定,多 結晶 Si 薄膜の平均結晶粒径と SPV の関係を 調べた。

(2) AC SPV 法による不純物汚染した Si 表面 における不純物の挙動及び酸化膜成長への影 響の解析

微量のAu, Fe, 及びCr汚染したn型Si ウェーハ表面を自然酸化または熱酸化し,酸 化膜成長をエリプソメータにより,また表面 ポテンシャル及び金属誘起酸化膜電荷をAC SPV法により調べた。また,波長980 nmの 励起光源を用いてAC SPV測定を行い,Au 汚染したn型Siにおける少数キャリアライフ タイムを求めた。

4. 研究成果

(1) SPV 法による多結晶 Si 薄膜の結晶性評価 新たに励起光源と SPV 測定部を一体 化した小型 SPV プローブを作製し,これ を用いた非接触型の多結晶 Si 薄膜結晶 性評価装置を立ち上げた。本装置を用い て,非接触で結晶性評価が可能である事 を確認した。また,従来の問題点である 面内 SPV 分布を解消し,平面走査による マッピング評価が可能となった。 図1に,製作したSPVプローブの概略 及び試料表面とSPV検出部のギャップ 間隔(Air gap)とSPVの関係を示す。Air gapとACSPVの関係は反比例的であり, ACSPVが多結晶Si薄膜とSPV検出部 による容量結合で検出されていることを 意味している。SPVプローブ部の小型化に よる平面分解能の向上と高感度化により,試 料表面とプローブの間隔を0.1 mm程度まで 大きくすることを可能にし,実用化に向けて 進展させた。



図2に、多結晶Si薄膜の平均結晶粒径と ACSPVの関係を示す。結晶粒径はSeccoエ ッチングを行った複数の試料について FE-SEM観察像から結晶粒の面積を求め、結 晶粒が円形であるとして求めた。平均結晶粒 径とACSPVはほぼ線形の関係を示している。 これは、励起されたキャリアのライフタイム が結晶粒界までの拡散時間に依存しているた めと考えられる。



更にボトムゲート型 TFT 構造試料におい て、本装置によって AC SPV が検出できるこ とが確認された。しかしながら、検出された AC SPV は小さく、更なる高感度化が必要で ある。

(2) AC SPV 法による不純物汚染した Si 表面に おける不純物の挙動及び酸化膜成長への影響 の解析

①Au 汚染した n 型 Si ウェーハ

図 3 は,温度 550~800 ℃で 10 分間 熱酸化した Au 汚染 n 型 Si ウェーハにお ける AC SPV 周波数特性である。AC SPV は低周波では一定値を取り、高周波領域 では周波数に反比例して減少している。 これは,n型Siウェーハ表面が弱反転状 態であることを意味している。SEM 及び AFM 観察により、Au はクラスターとし て SiO2表面及び Si/SiO2界面に存在して いることが分かった。Si/SiO2界面に存在 する Au により Au/n 型 Si ショットキー 接触が形成されていることが, AC SPV 周波数特性により明らかになった。また, 酸化温度の増大により AC SPV は減少し, Si 中への Au の拡散が進むことを示して いる。



図3 熱酸化 Au 汚染 n 型 Si ウェーハに おける AC SPV 周波数特性

図4は,温度750~900 ℃で熱酸化したAu汚染n型Siウェーハにおける酸化時間と酸化膜厚の関係を示している。比較のため、フッ化水素酸(HF)処理したn型Siウェーハについても示した。明らかにAu汚染したn型Siウェーハの酸化膜厚は厚い。この酸化膜成長の増速は、SiO₂/Si界面におけるAuの存在を示すACSPVの発生と対応しており、界面のAuクラスターが酸化膜成長を増速させる触媒として働く事を明らかにした。図5は、波長980nmの励起光を用いて測定

した AC SPV 周波数特性から求めた Au 汚染 n 型 Si ウェーハにおける少数キャリアライフタ イムの熱酸化による変化を示している。酸化 温度及び時間の増大により少数キャリアライ フタイムは減少しており, SiO₂/Si 界面に析 出した Au の n型 Si ウェーハ中への拡散 が進んでいくことを示している。この値 とマイクロ波光導電減衰法により求めた少数 キャリアライフタイムとは良い対応が得られ, AC SPV により Si 内部のキャリア挙動を調べ られることを確認した今後, Si 表面及び内部 のキャリア挙動の分別について検討を行って いく。



図 4 熱酸化した Au 汚染 n 型 Si における 熱酸化膜成長の増速



図 5 熱酸化した Au 汚染 n 型 Si における 少数キャリアライフタイムの変化

②Fe 汚染した n 型 Si ウェーハ

図 6 は, 温度 100~550 ℃で 60 分間 熱酸化した Fe 汚染 n 型 Si ウェーハの AC SPV 周波数特性を示している。Au 汚染試料と同様に、AC SPV は低周波で は一定値を取り、高周波領域では周波数 に反比例して減少しており、n型 Si 表面 は弱反転状態であることが分かる。これ は 3 価の Fe が SiO₂中で 4 価の Si と置 換し、図 7 に示すように(FeOSi)⁻ネットワ ークを形成するためである。Fe は SiO₂表面 から約 3 nm の範囲に分布し、負電荷を 発生させる事が分かった。この Fe 誘起酸 化膜負電荷量は、酸化温度約 400 ℃で極小と なり、この温度(約 400 ℃)を境界に、低温 と高温では Fe による酸化膜負電荷の発生と Fe の挙動は異なることが示唆された。



図 6 熱酸化 Fe 汚染 n 型 Si ウェーハに おける AC SPV 周波数特性



 図7 Feにより酸化膜中に誘起される (FeOSi)⁻ネットワークの模式図

③Cr 汚染した n 型 Si 表面

図8は,温度550~900 ℃で10分間 の熱酸化をしたCr汚染n型Siウェーハ のACSPV周波数特性を示している。Fe 汚染n型Si試料と同様に、3価のCrが SiO2中で4価のSiと置換し、図9に示 したように(CrOSi)またはCrO2ネットワー クを作り負電荷を発生させる事をACSPV周 波数特性より明らかにした。ACSPVは高温 の熱酸化で減少していき、これらSiO2中の負 電荷を発生するネットワークは高温・長時間 の酸化により崩壊していくことを示している。 また、温度500 ℃以下の比較的低温で熱酸 化した Cr 汚染 n 型 Si ウェーハでは,酸化温度 300~400 ℃において発生する酸化膜電荷 が最も多くなることが分かった。



図8 熱酸化 Cr 汚染 n 型 Si ウェーハに おける AC SPV 周波数特性



図 9 Cr により酸化膜中に誘起される (CrOSi)⁻または CrO₂⁻ネットワークの 模式図

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計5件)

①<u>池田正則</u>,<u>清水博文</u>,高松弘行,迫田尚和, 表面光電圧法による多結晶シリコン薄膜の結晶 性評価,日本大学工学部紀要,査読有,第52 巻,第2号,2011,35-40.

②<u>H. Shimizu</u>, S. Shimada , and <u>M. Ikeda</u>, Negative Oxide Charge in Thermally Oxidized Cr-Contaminated n-Type Silicon Wafers , Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, Vol. 49, 2010, 038001. ③<u>H. Shimizu</u>, S. Shimada , S. Nagase , S. Muta , and <u>M. Ikeda</u>, Irregular Au profile on the SiO₂ surface and at the SiO₂/Si interface and the oxidation kinetics of thermally oxidized Au-contaminated n-Si (001) surface , J. Vac. and

Technol., 査読有, Vol. 28, 2010, 94-98. ④嶋田定剛, <u>清水博文</u>, <u>池田正則</u>, Cr故意汚染 して熱酸化した n型 Siの交流表面光電圧法によ る金属誘起電荷の解析, 日本大学工学部紀要, 査読有, 第 51 巻, 第 1 号, 2009, 33-41. ⑤<u>H. Shimizu</u>, H. Wakashima, S. Shimada, T. Ishikawa and <u>M. Ikeda</u>, Au/N-type Si Schottky-barrier contact and oxidation kinetics in Au-contaminated and thermally oxidized N-type Si (001) surfaces, Surface and Interface Analysis, 査読有, Vol. 40, 2008, 627-630.

〔学会発表〕(計19件)

①眞田 悠司(<u>清水博文</u>), Au 析出した n 型 Si 表面におけるショットキー障壁の形成と熱酸化に よる崩壊, 平成 22 年度日本表面科学会東北・北 海道支部講演会, 2010.3.10, 東北大学多元研. ②<u>池田 正則(清水博文</u>), 非接触表面光電圧プ ローブを用いた多結晶シリコン薄膜の結晶性評 価, 平成 22 年度電気関係学会東北支部連合大

会, 2010.8.26, 八戸工業大学.

③ <u>H. Shimizu</u>, Photon-assisted surface photovoltage in thermally oxidized metal -contaminated n-type silicon wafers , 7th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, 17 August 2010, Copenhagen and Sonderborg, Denmark.

④大槻智大(<u>清水博文</u>),熱酸化した Fe 汚染 n
型 Si(100)表面における酸化膜負電荷の解析,
応用物理学会東北支部第 64 回学術講演会,
2009.12.4,日本大学工学部.

⑤長瀬慎太郎(<u>清水博文</u>), 熱酸化した Cr 汚染 n型及びp型Si(100)表面における酸化膜成長と 酸化膜電荷の評価, 応用物理学会東北支部第 64 回学術講演会, 2009.12.4, 日本大学工学 部.

⑥牟田壮志郎(<u>清水博文</u>), 熱酸化した Sb 汚染 p型 Si(100)表面における酸化膜成長と酸化膜電 荷の評価, 応用物理学会東北支部第 64 回学術 講演会, 2009.12.4, 日本大学工学部.

⑦大槻智大(<u>清水博文</u>), 交流表面光電圧法に よる熱酸化した Fe 汚染 n 型 Si における酸化膜 電荷の評価, 第 70 回応用物理学会学術講演会, 2009.9.10, 富山大学.

⑧長瀬慎太郎(<u>清水博文</u>), 熱酸化した Cr 汚染 n 型及び p 型 Si(100)表面における Cr の挙動, 第 70 回応用物理学会学術講演会, 2009.9.10, 富山大学.

⑨牟田壮志郎(<u>清水博文</u>),交流表面光電圧法による熱酸化した P 汚染及び Sb 汚染 p 型 Si における酸化膜電荷の評価,第70回応用物理学会学術講演会,2009.9.10,富山大学.

⑩<u>池田正則(清水博文</u>), 非接触 SPV 測定による 多結晶シリコン薄膜の結晶性評価, 第 70 回応用 物理学会学術講演会, 2009.9.9, 富山大学.

①大槻智大(<u>清水博文</u>), 熱酸化した Fe 故意汚染n型 Si(100)表面における Fe 誘起酸化膜負電荷の解析, 応用物理学会東北支部第 63 回学術講演会, 2008.12.4, 東北大学.

12長瀬慎太郎(<u>清水博文</u>), Si(100)表面における 熱酸化膜成長に及ぼす Cr の影響,応用物理学 会東北支部第 63 回学術講演会, 2008.12.4, 東 北大学.

¹³年田壮志郎(<u>清水博文</u>), Si(100)表面における 熱酸化膜成長に及ぼす P 及び Sb の影響, 応用 物理学会東北支部第 63 回学術講演会, 2008.12.4, 東北大学.

H <u>H. Shimizu</u> ,Formation and Collapse of Au/n-Si Schottky-Barrier Contact at the SiO₂/Si Interface and Oxidation Kinetics in Au-Contaminated and Thermally Oxidized n-Si(001) Surfaces, AVS 55th International Symposium & Exhibition, October , 2008, Boston, USA.

¹⁵嶋田定剛(<u>清水博文</u>), 熱酸化した Au 故意汚 染n型Si(100)表面におけるAuの挙動(その2), 第69回応用物理学会学術講演会, 2008.9.3, 中 部大学.

⑩<u>池田正則(清水博文</u>),表面光電圧法による多 結晶シリコン薄膜の結晶性評価,第69回応用物 理学会学術講演会,2008.9.2,中部大学.

 ①年田壮志郎(<u>清水博文</u>), Au による n 型 Si(100)表面における熱酸化膜成長の増速, 平成
20 年度電気関係学会東北支部連合大会,
2008.8.21, 日本大学工学部.

18長瀬慎太郎(<u>清水博文</u>), Au 故意汚染して熱酸化した n型 Si(100)表面における Au の分布,平成 20 年度電気関係学会東北支部連合大会,2008.8.21,日本大学工学部.

¹⁹大槻智大(<u>清水博文</u>),交流表面光電圧法に よるn型 Si(100)表面におけるFe 誘起酸化膜負 電荷の解析,平成20年度電気関係学会東北支 部連合大会,2008.8.21,日本大学工学部.

6. 研究組織

(1)研究代表者

清水 博文(SHIMIZU HIROFUMI)
日本大学・工学部・教授
研究者番号:10318371

(2)研究分担者

池田 正則(IKEDA MASANORI)
日本大学・工学部・准教授
研究者番号:10222902